

Flexibler 1-Komponenten-Klebstoff für die Mikroelektronik

EPOXONIC 71 ist ein silbergefülltes Einkomponenten-Material auf Epoxidbasis.
Die herausragenden Eigenschaften sind:

- Hohe Flexibilität
- lange Gebrauchsdauer
- geringer Chlorgehalt

Anwendungen

EPOXONIC 71 eignet sich wegen seiner Flexibilität besonders für die Klebung von größeren Chips.

Eigenschaften

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Farbe | silber |
| • Viskosität (25 °C) | ≥ 30000 mPa.s |
| • Silbergehalt | ca. 71% |

Verarbeitung

- | | |
|----------------------------|---|
| • Verarbeitungstemperatur: | z. B. 25 °C |
| • Applikation: | z. B. Dispenser |
| • Gebrauchsdauer : | ca. 7 Tage bei 25 °C |
| • Härtingsbedingungen: | z. B. 120 °C/45 min + 140 °C/2 h
(evt. tempern bei 160 °C/1 h) |

Qualitätssicherung

Nach Vereinbarung wird **EPOXONIC 71** mit Zertifikat geliefert.

Lieferform

EPOXONIC 71 wird als Einkomponentenmaterial (frozen product) in Kartuschen geliefert. Andere Lieferformen sind auf Wunsch erhältlich.

Lagerfähigkeit

EPOXONIC 71 ist gut verschlossen im Gefrierschrank mindestens 6 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Es gelten die bei der Verarbeitung von Epoxidharzen zu beachtenden Sicherheitsvorkehrungen und Körperschutzmaßnahmen. Nähere Hinweise sind dem Merkblatt M-023 „Epoxidharze, Polyester“ der Berufsgenossenschaft Chemie zu entnehmen.

Wichtige Anwenderinformation

Die Angaben dieses Datenblattes werden nach bestem Wissen gemacht, jedoch unter Ausschluß jeglicher Haftung. Sie gelten nicht als Genehmigung zur lizenzfreien Verwendung, sondern sind lediglich als Arbeitshilfe für den Anwender gedacht, der jedoch seine eigenen Versuche durchführen sollte, um die Eignung des Produktes für seine speziellen Anforderungen festzustellen.